

エッチング剤 (蒸着膜、ペースト、セラミック、半導体チップ上)

商品名	特徴	品番・作業条件	荷姿	用途
CR-11	<ul style="list-style-type: none"> ■ 薄膜Cr-Cu膜中のCrの除去 ● CuはエッチングせずCrのみをエッチング除去する ● 親水性を与える ● バンプ形成時におけるCr除去 	500ml/ℓ～原液使用 50～70℃	20L	<ul style="list-style-type: none"> ○ 薄膜パターン ● Siウエハーの親水性付与 ● フレキ基板 ● バンプ
MC-WM	<ul style="list-style-type: none"> ■ W、Mo-Mn合金ペースト、Cu-W、W、Mo、Mo-Cuのエッチング剤 ● めっきの密着やショートを改善する ● W、Mo、蒸着膜のパターニング ● Cr薄膜の除去 ● Cr-Moの鋼のエッチング、密着性の改良 	100ml/ℓ～原液使用 RT～50℃	20L	<ul style="list-style-type: none"> ○ セラミックス ● ICパッケージ ● PGA、MPU ● ヒートシンク ● 薄膜 ● バンプ
ETW (ノーシアン)	<ul style="list-style-type: none"> ■ W、Mo-Mn合金ペースト、Cu-W、W、Mo、Mo-Cuのエッチング剤 ● めっきの密着やショートを改善する ● W、Mo、蒸着膜のパターニング ● Cr薄膜の除去 ● Cr-Moの鋼のエッチング 	ETW-1 50g/ℓ ETW-2 500ml/ℓ	16kg 20L	<ul style="list-style-type: none"> ○ セラミックス ● ICパッケージ ● PGA、MPU ● ヒートシンク ● 薄膜 ● バンプ
MC-E	<ul style="list-style-type: none"> ■ フッ化物系エッチング補助剤 ● HCℓ、H₂SO₄との併用 ● 酸化皮膜を除去し、めっきの密着性を高める ● 特にガラス質の除去に最適 ● W、Mo-Mnペースト上の密着改良、ショート防止に効果あり 	MC-E 100ml/ℓ～原液使用 HCℓ、H ₂ SO ₄ 200ml/ℓ	20L	<ul style="list-style-type: none"> ○ 鋳物 ● SUS ● 42アロイ ● コバルト ● 半導体セラミック ● ハーメチックシール部品
MC-E5 (ノーシアン)	<ul style="list-style-type: none"> ■ W、Mo-Mnペーストのエッチング ● AlNのW、Mo-Mnペーストのエッチング ● Agペーストのエッチング ● Cu-W合金ペースト 	MC-E5 100～300ml/ℓ H ₂ O ₂ 200～800ml/ℓ	20L	<ul style="list-style-type: none"> ○ セラミックス ● ICパッケージ ● PGA ● Ag、Ag-Pd
MC-EC	<ul style="list-style-type: none"> ■ セラミック(チタバリ)のエッチング液 ● セラミックをエッチングし、めっきの密着を向上させる 	100ml/ℓ～原液使用 50～60℃	20L	<ul style="list-style-type: none"> ○ チタバリ系
MC-ET	<ul style="list-style-type: none"> ■ SiO₂膜の除去 ● めっきの前処理 ● フッ酸の代用(安全性) 	原液使用	20L	<ul style="list-style-type: none"> ○ シリコンウエハー上のめっきの前処理
ET-13	<ul style="list-style-type: none"> ■ シリコンウエハー及びSiのエッチング剤 ● めっきの前処理剤 ● めっきの密着がよくなる 	原液使用	20L	<ul style="list-style-type: none"> ○ トランジスタ ● 太陽電池 ● サイリスター
ET-70	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cu₂O₂、CuOのエッチング剤 ● Cu製ピンの亜酸化銅の除去 ● クラッドCuのエッチング ● ガラスを痛めない 	原液使用 90～100℃	20L	<ul style="list-style-type: none"> ○ 温度センサーピン ● コンデンサーピン ● 抵抗ピン ● リードピン
ET-70K	<ul style="list-style-type: none"> ■ 化研用添加剤 ● 過酸化水素に添加する ● 従来の化研剤より安価 ● バリ取り剤 	ET-70K 300ml/ℓ H ₂ O ₂ 270ml/ℓ	20L	<ul style="list-style-type: none"> ○ コバルト ● 42アロイ ● ハーメチック部品 ● 鉄系
ET-022F	<ul style="list-style-type: none"> ■ セラミックの特殊エッチング剤 ● 化学銅・化学Niの密着を改善する 	100～500ml/ℓ	20L	<ul style="list-style-type: none"> ○ チタバリ系
PT-1	<ul style="list-style-type: none"> ■ PZT用一次エッチング剤 ● PT-2と併用して、めっきの密着が向上する 	原液使用	20L	<ul style="list-style-type: none"> ○ PZT
PT-2	<ul style="list-style-type: none"> ■ PZT用二次エッチング剤 ● めっきの密着の向上 	原液使用	20L	<ul style="list-style-type: none"> ○ PZT

商品名	特徴	品番・作業条件	荷姿	用途
ET-MKC	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ag-Cu-Tiロウ除去剤 ● Cuパターンの溶解を抑えてAg-Cuロウを除去する 	ET-MKC-1 100~300ml/l ET-MKC-2 15~50g/l H ₂ O ₂ 100~500ml/l アンモニア水 15~30ml/l	20L 20kg	<ul style="list-style-type: none"> ○ セラミックス ● 放熱板 ● ヒートシンク ● DBC基板
	<ul style="list-style-type: none"> ● Cuパターン、Ag-Cuロウの溶解を抑えて、Ti合金化膜を除去する 	ET-MKC-31 100~300ml/l H ₂ O ₂ 50~300ml/l アンモニア水 10~30ml/l	20L	
ET-AGA	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ag-Cuロウのエッチング剤 ● 酸性タイプ ● コバルト、Ag-Cu、Ni-B、Ni-Pが一度にエッチングされる ● 氷酢で洗浄する 	500ml/l ~ 原液使用 RT	20L	<ul style="list-style-type: none"> ○ PGA等で金具取付け後RTの異種金属のエッチング ● LPC (レーザーパワーキャップ) ● ハーメチックシール
ET-AGB	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ag-Cuロウのエッチング剤 ● アルカリシアンタイプ ● コバルト、Ag-Cuロウ、Niが一度にエッチングされる ● 密着をよくする 	ET-AGB 10~50g/l KCN 10~30g/l	8kg	<ul style="list-style-type: none"> ○ PGA等で金具取付け後RTの異種金属のエッチング ● LPC (レーザーパワーキャップ) ● OSCキャップ
HN-25	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ag、Ag-Pdペーストのエッチング剤 ● 密着改善、リークがなくなる ● 金属酸化物の除去 	50~500ml/l	20L	<ul style="list-style-type: none"> ○ セラミック基板 ● チップコンデンサー ● CR ● リードフレーム
HC-55	<ul style="list-style-type: none"> ■ 密着改良剤 ● 鉄系、SUS系に有効 	100~700ml/l	20L	<ul style="list-style-type: none"> ○ コバルト ● 42アロイ ● リードフレーム
HS-55	<ul style="list-style-type: none"> ■ 密着改良剤 ● 弱いエッチング ● Cu-W合金に有効 	100~500ml/l	20L	<ul style="list-style-type: none"> ○ PCB ● Cu系リードフレーム